LAGENAUFBAU HDI (Standard)

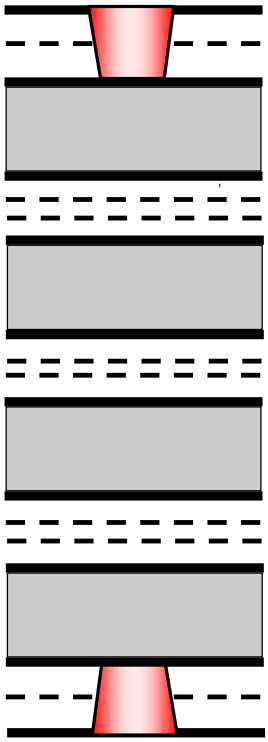
HDI10_1+8+1_1,30_17.5

10 - Lagen

Kerne: 0,15 mm Cu 17.5/17.5 µm

WE-Artikel Nr.:	**1 + 8 + 1**
KUNDE:	

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG KUNDE	LAGENBEZEICHNUNG WE	AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE [µm]	KUNDEN-FORDERUNG [µm]
1	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	**12**	
					1 x 1080	**66**	
2	2			17.5 µm		**16**	
			0,150 mm			**150**	
3	3			17.5 µm		**16**	
					2 x 1080	**134**	
4	4			17.5 µm		**16**	
			0,150 mm			**150**	
5	5			17.5 µm		**16**	
					2 x 1080	**134**	
6	6			17.5 µm		**16**	
			0,150 mm			**150**	
7	7			17.5 µm		**16**	
					2 x 1080	**134**	
8	8			17.5 µm		**16**	
			0,150 mm			**150**	
9	9			17.5 µm		**16**	
					1 x 1080	**66**	
10	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	**12**	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 55 µm

Gesamtdicke Material:						1286	

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

							Datum:	Bearbeiter:
MATERIALDICKE:	**1,30**	+/-	0,10	mm				
DICKE über galv. Endoberfläche	1,39	+/-	0,13	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,45	+/-	0,15	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
27.03.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	04.05.2006	R. Schönholz	00	5+